# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-301076

(43) Date of publication of application: 30.10.2001

(51)Int.Cl.

B32B 5/18 B32B 27/32

(21)Application number: 2000-121562

(71)Applicant: MITSUBISHI KAGAKU FORM

PLASTIC KK

(22)Date of filing:

21.04.2000

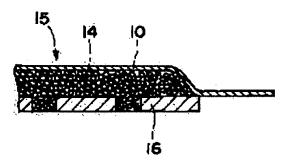
(72)Inventor: TANAKA MASANORI

YOKOYAMA MASAAKI

#### (54) POLYOLEFINIC RESIN COMPOSITE MOLDED OBJECT

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polyolefinic resin composite molded object by developing a molding technique capable of molding a foam layer at temperature not deteriorating the surface quality of a skin layer and making the adhesiveness of the foam layer, the skin layer or/and a base material excellent. SOLUTION: In the polyolefinic resin composite molded object constituted of the skin layer 10 and the foam layer 14 or the skin layer 10, the foam layer 14 and the base material 16, the foam layer 14 is constituted by molding thermoplastic foamable resin particles each consisting of a foamed core layer comprising a crystalline thermoplastic resin and a polyethylenic resin coating layer covering the core layer under heating to mutually fuse them and the skin layer 10 is constituted of a thermoplastic synthetic resin of which the melting point is higher than that of the polyethylenic resin constituting the coating layers of the particles by 5° C or higher.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

# (II)特許出願公開番号 特開2001-301076

(P2001-301076A) (43)公開日 平成13年10月30日(2001.10.30)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

B32B 5/18

27/32

B32B 5/18

4F100

27/32

E

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願2000-121562(P2000-121562)

(22)出願日

平成12年4月21日(2000.4.21)

(71)出願人 599050893

三菱化学フォームプラスティック株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目10番1号

(72)発明者 田中 雅典

三重県四日市市大字六呂見653-2 三菱

化学フォームプラスティック株式会社四日

市工場内

(72)発明者 横山 正明

三重県四日市市大字六呂見653-2 三菱

化学フォームプラスティック株式会社四日

市工場内

(74)代理人 100089244

弁理士 遠山 勉 (外2名)

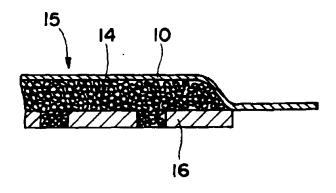
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】ポリオレフィン系樹脂複合成形体

#### (57)【要約】

【課題】 表皮層の表面品質を劣化させることがない程度の温度で発泡体層の成形ができ、発泡体層と表皮層又は/及び基材との接着性に優れた成形技術を開発し、樹脂複合成形体を得ること。

【解決手段】 表皮層10と発泡体層14、或いは表皮層10と発泡体層14と基材16とから構成されるポリオレフィン系樹脂複合成形体において、発泡体層14を、結晶性熱可塑性樹脂からなる発泡状態の芯層と、これを被覆するポリエチレン系樹脂被覆層とからなる熱可塑性発泡樹脂粒子を加熱成形して互いに融着させた発泡体層によって構成し、表皮層10を、融点が前記粒子の被覆層を構成するポリエチレン系樹脂の融点より5℃以上高い熱可塑性合成樹脂で構成したことを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表皮層と発泡体層、或いは表皮層と発泡体層と基材とから構成されるボリオレフィン系樹脂複合成形体において、

1

前記発泡体層を、結晶性熱可塑性樹脂からなる発泡状態の芯層と、該芯層を被覆するポリエチレン系樹脂被覆層とからなる熱可塑性発泡樹脂粒子を加熱成形して互いに融着させた発泡体層によって構成し、表皮層を、融点が前記粒子の被覆層を構成するポリエチレン系樹脂の融点より5℃以上高い熱可塑性合成樹脂で構成したことを特 10 徴とするポリオレフィン系樹脂複合成形体。

【請求項2】 表皮層を構成する熱可塑性合成樹脂がポリオレフィン系樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポリオレフィン系樹脂複合成形体。

【請求項3】 発泡体層の圧縮硬さが0.05~0.7 MPaであることを特徴とする請求項1又は2に記載のポリオレフィン系樹脂複合成形体。

【請求項4】 発泡体層の空隙率を1~40%としたことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のポリオレフィン系樹脂複合成形体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はポリオレフィン系樹脂複合成形体に関し、更に詳細には熱可塑性発泡樹脂粒子を用いたポリオレフィン系樹脂複合成形体に関する。 【0002】

【従来の技術】従来、車両用内装部材には、ソリッド樹脂からなる基材と表皮との間に発泡層を介在させることにより、ソフト感を付加して高級化を図ったものがあり、このような車両用内装部材の製造方法は、特許掲載 30公報(特許第2500645号)に開示されている。

【0003】上記特許掲載公報に開示された車両用内装部材の製造方法は、ボリブロピレン製の表皮用シートを一方の成形型に設置し、他方の成形型にはボリプロピレン製でフィラー入りのソリッド樹脂からなる基材を設置し、これら表皮用シートと基材との間の空間部にボリブロピレンからなる発泡樹脂粒子を充填し、粒子同士を融着して発泡体層とした成形体を形成するものである。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 40 成形体製造技術では、発泡樹脂粒子の融着を行う際に高 温又は髙圧蒸気加熱を必要とするため、表皮層の表面品質が加熱時に熱によって劣化するという問題があった。 そのため、内装部材として表皮面に意匠的なデザインを施した場合にそのデザインが目立ち難くなるという問題があった。また、低温で成形すると、発泡樹脂粒子同士の融着が悪くなると共に表皮層と発泡層の接着、及び発泡層と基材との接着も悪くなるという問題があった。

【0005】更に、前述したような従来の複合成形体製造技術では、表皮用シートと発泡樹脂粒子との接着性を50

上げるため、高温の蒸気で長い間加熱する必要が生じ、 そのため加熱融着時に、発泡樹脂粒子の空隙又は粒子の 中に水分が気体状態で多量に浸入し、この状態で冷却す ると水分が気体から液体の状態に凝縮し、大きく体積収 縮を起こす。

【0006】このため、発泡樹脂粒子の空隙又は粒子の中が減圧状態になり、かかる粒子からなる発泡成形体が収縮、変形することになり、形状安定性が悪く、型通りの成形体が得られ難く、しかも表皮の表面外観が悪いという問題があった。また、発泡成形体においては、発泡樹脂粒子が充分に融着して、機械的強度が高いことも要求される。

【0007】本発明者は、従来の発泡体層を備える複合成形体におけるこのような問題に対して鋭意研究した結果、表皮層の表面品質を劣化させることがない程度の温度で発泡体層の成形ができ、発泡体層と表皮層又は/及び基材との接着性に優れた成形技術を開発し、樹脂複合成形体を得た。

[0008]

20

【課題を解決するための手段】本発明はポリオレフィン系樹脂複合成形体であり、前述した技術的課題を解決するために以下のように構成されている。すなわち、本発明は、表皮層と発泡体層、或いは表皮層と発泡体層と基材とから構成されるポリオレフィン系樹脂複合成形体において、前記発泡体層を、結晶性熱可塑性樹脂からなる発泡状態の芯層と、該芯層を被覆するポリエチレン系樹脂被覆層とからなる熱可塑性発泡樹脂粒子を加熱成形して互いに融着させた発泡体層によって構成し、表皮層を、融点が前記粒子の被覆層を構成するポリエチレン系樹脂の融点より5℃以上高い熱可塑性合成樹脂で構成したことを特徴とする。

【0009】<本発明における具体的構成>本発明のボリオレフィン系樹脂複合成形体は、前述した必須の構成要素からなるが、その構成要素が具体的に以下のような場合であっても成立する。その具体的構成要素とは、表皮層を構成する熱可塑性合成樹脂がボリオレフィン系樹脂であることを特徴とする。また、発泡体層の圧縮硬さを0.05~0.7MPaとすることも好ましい。更に、発泡体層の空隙率を1~40%とすることも好ましい。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明のポリオレフィン系樹脂複合成形体を構成する発泡体層は、特定の芯層とこれを被覆する被覆層とからなる発泡樹脂粒子を用いている。そのため、発泡樹脂成形体の製造時に従来加熱媒体として用いられてきた高温・高圧のスチーム(水蒸気)を使用せず、比較的低温・低圧のスチームや乾燥ガスからなる熱風にて加熱することで発泡樹脂成形体を得ることができる

【0011】芯層は、通常、結晶性の熱可塑性樹脂にて

10

構成される。かかる結晶性の熱可塑性樹脂としては、例 えば、ボリエチレン系樹脂、ボリブロピレン系樹脂、ボ リブテン系樹脂、ポリメチルペンテン系樹脂、ポリエス テル系樹脂、ポリアミド系樹脂、フッ素系樹脂、結晶性 スチレン系樹脂などが挙げられる。この中でも、プロピ レン単独重合体、プロピレンとプロピレン以外の $\alpha$ -オ レフィンとのランダム共重合体やブロック共重合体が好 ましい。これにより、安価でリサイクル性に優れ、軽量 で断熱性及び緩衝性に優れた樹脂複合成形体を得ること ができる。

【0012】被覆層は、実質的に非発泡状態であること が好ましい。「実質的に非発泡状態」とは、気泡構造の ないフィルム状態を意味する。また、そのフィルム状態 は穴が開いていても良く、例えば網目状態のものであっ ても良い。また、被覆層は上記芯層の熱可塑性樹脂より 融点が低いか、又は実質的に融点を示さないエチレン系 重合体を含有する。被覆層の融点は上記芯層を構成する 熱可塑性樹脂の融点より15℃以上低いことが好まし く、熱可塑性樹脂との温度差は、好ましくは20~60 ℃、より好ましくは20~40℃の範囲である。

【0013】「実質的に融点を示さない」とは非晶質な 樹脂であるため示差走査熱量計による融点測定を行って も結晶融点を示さないものを意味する。但し、比較的低 温で樹脂同士が融着することから被覆層として使用し得 る。このような熱可塑性樹脂の場合、仮の融点を100 ℃として芯材を構成する結晶性熱可塑性樹脂との融点差 を計算する(後述する表皮層との融点差を云う場合も同 様である)。

【0014】かかる低融点のエチレン系重合体として は、髙圧法低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチ 30 レン、直鎖状超低密度ポリエチレンの他、酢酸ピニル、 不飽和カルボン酸エステル、不飽和カルボン酸、ビニル アルコール等とエチレンの共重合体が挙げられる。

【0015】実質的に融点を示さないエチレン系重合体 としては、例えば、エチレン・プロピレンゴム、エチレ ン・プロピレン・ジエンゴム、エチレン・アクリルゴ ム、塩素化ポリエチレンゴム、クロロスルホン化ポリエ チレンゴム等のゴム・エラストマーが挙げられる。これ らのエチレン系重合体は、単独使用の他、2種以上の組 成物として使用することができる。

【0016】上記の被覆層を構成するエチレン系重合体 の中では、高圧法低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポ リエチレン、直鎖状超低密度ポリエチレンが好ましい。 中でもメタロセン触媒を使用して重合された直鎖状低密 度ポリエチレン、直鎖状超低密度ポリエチレンが最も好

【0017】被覆層を構成する上記のエチレン系重合体 の融点は実質的にないか、又は融点があったとしても1 25℃以下であることが好ましい。その理由は、発泡樹

とができるからである。更に、被覆層としては、芯層を 構成する熱可塑性樹脂に対し、15℃以上低い融点のエ チレン系重合体を選択して使用するのが好ましい。

【0018】上記の融点差が15℃未満の場合、芯層の 熱可塑性樹脂を発泡させる条件下においては、エチレン 系重合体からなる被覆層が発泡する虞がある。また、上 記の被覆層は、上記エチレン系重合体と、芯層と同種の 結晶性熱可塑性樹脂との混合物であることが好ましい。 これにより、被覆層と芯層との接着性が向上する。

【0019】被覆層における熱可塑性樹脂の配合割合 は、エチレン系重合体100重量部に対し、1~100 重量部の範囲から選択されることが好ましい。熱可塑性 樹脂の配合割合が1重量部未満の場合には、芯層と被覆 層との接着性向上の効果が低くなるおそれがある。ま た、100重量部を超える場合には、被覆層の海島形態 が変化し、熱可塑性樹脂が連続した海の相を構成するこ ととなり、成形時の加熱温度があまり低くならない。

【0020】更に、熱可塑性樹脂の混合割合は、エチレ ン系重合体100重量部に対し、1~50重量部の範囲 20 であることが望ましい。これにより、芯層と被覆層との 接着性が向上し、また成形時の加熱温度を低くすること ができる。

【0021】発泡樹脂粒子において、被覆層の厚さは1  $\sim 150 \mu \text{m}$ であることが好ましい。被覆層の厚さが1μm未満の場合には、成形の際、加熱温度を十分に低下 させる効果が少ない。一方、被覆層の厚さが150μm を超える場合には、成形の際、加熱温度は下げることが できるものの、被覆層における実質的に非発泡性部分の 割合が大きく、成形体の機械的強度が発泡倍率の割には 低くなる傾向にある。更には、被覆層の厚みは10~1 00μmであることが好ましい。これにより、成形の際 に加熱温度を下げることができ、且つ樹脂複合成形体の 機械的強度を高めることができる。

【0022】図1に本発明のポリオレフィン系樹脂複合 成形体に係る発泡体層を構成する発泡樹脂粒子1を示 す。図1に示す如く、発泡樹脂粒子1の長径Lと短径D とのL/D比は0.5~3程度である。0.5未満の場 合には、被覆層3の表面積が少なくなり、融着不良をも たらす。また、L/D比が3を超える場合には、粒子形 40 状が細長となり、充填効率が悪化し、成形不良や形状安 定性の低下をもたらす。

【0023】L/D比は、1.5~3と比較的大きい場 合には空隙の多い成形体を得やすくなるが、成形性の点 から、0.8~2であることが好ましい。また、発泡体 **園を構成する発泡樹脂粒子1の短径Dの平均即ち平均粒** 子径は、1~6mm、好ましくは1. 5~4. 0mmが よい。

【0024】発泡樹脂粒子1は、例えば、図1に示され るように結晶性の熱可塑性樹脂からなる芯層2と、熱可 脂粒子を成形する際の加熱温度をより低温に設定するこ 50 塑性樹脂より融点が低いか、又は実質的に融点を示さな

いエチレン系重合体を含有する被覆層3にて構成される 複合体粒子に揮発性発泡剤を含浸させた後、加熱発泡し て得られる。

【0025】上記の揮発性発泡剤としては、プロパン、プタン、ペンタン、ヘプタン、シクロペンタン、シクロヘキサン等の低級脂肪族炭化水素類、ジクロロジフロロメタン、トリクロロモノフロロメタン等のハロゲン化炭化水素、窒素、空気、炭酸ガス等の無機ガス等が挙げられ、これらは、単独又は2種類以上組み合わせて使用される。

【0026】発泡樹脂粒子は、蒸気や熱風にて加熱成形される。ここで、熱風の場合は、電熱ヒーター、蒸気ヒーター等の加熱手段により空気を加熱して得られる。また、ブロアー、圧縮空気を利用して供給すると、発泡樹脂粒子を効率よく加熱することができる。更に、熱風を回収、循環する方式を利用することにより熱エネルギーのロスを少なくすることができる。

【0027】熱風を用いる場合は水蒸気が50KPa以下の乾燥ガスが好適に用いられる。これにより、加熱成形時に発泡樹脂粒子の空隙又は粒子の中に水蒸気が浸入20することを防止でき、樹脂複合成形体の形状安定性を確保できる。また、加熱成形時における、発泡樹脂粒子の加熱温度は、芯層となる結晶性の熱可塑性樹脂の融点よりも低い温度で行う。好ましくは、上記樹脂の融点より5℃以上低い温度が望ましい。さらに、好ましくは融点より10℃以上低い温度が望ましい。また、被覆層の融点以上の加熱温度で成形される。

【0028】発泡樹脂粒子を加熱成形する際には、発泡樹脂粒子の圧縮状態は、成形体に要求される物性により適宜設定するが、圧縮を小さくすれば、発泡樹脂粒子同 30士の接触面積が少ない空隙のある成形体が得られる。本発明では、発泡体層の空隙率は、1%~40%であることが好ましい。なお、加熱と圧縮とは、何れを先に行っても良い。また、圧縮は加熱中であっても良い。

【0029】発泡樹脂粒子の加熱成形は、該発泡樹脂粒子の嵩容積を50~99%に圧縮して、見かけ密度を高くした状態で行うことが好ましい。50%よりも小さい状態に圧縮する場合には、殆ど空隙のない状態の樹脂複合成形体が得られることになり、樹脂複合成形体の密度が大きくなり過ぎる。99%よりも大きい場合には、発40泡樹脂粒子同士の接触面積がより小さくなり融着強度の弱い樹脂複合成形体になる。

【0030】また、発泡体層の圧縮硬さは、0.05~0.7MPa(JIS K6767に準拠して測定)であることが好ましく、特に0.07~0.6MPaにあることが好ましい。圧縮硬さが0.7MPaを超えると、発泡体層の発泡樹脂粒子が硬く、表皮層に粒子の痕跡が出やすく表面外観を損なうと共に、クッション性が劣る。また、0.05MPa以下であると発泡体層の発泡樹脂粒子がやわらかくなり表皮層に皺が発生しやすく50

なり、やはり表面外観を損なうと共に発泡樹脂成形体と しての強度が低下する。

【0031】また、発泡樹脂粒子は、結晶性の熱可塑性樹脂からなる独立気泡体である芯層とエチレン重合体を含有する実質的にフィルム状の被覆層とから構成されている。そのため、型内に充填された発泡樹脂粒子間の空隙に、熱容量の比較的に小さい蒸気や熱風を通過させることにより、被覆層よりも融点が高い芯層の軟化を抑えながら、被覆層が融着するのに必要な温度まで発泡樹脂粒子を加熱でき、その後、芯層が保有する圧縮反力を有効に活用して発泡樹脂粒子を融着させた樹脂複合成形体を得ることができる。

【0032】前述した発泡樹脂粒子は、発泡状態の芯層と、この芯層を被覆する実質的に非発泡状態のポリエチレン系樹脂被覆層とから構成される複合構造を有する。発泡状態の芯層は、例えば、独立気泡構造又は連続気泡構造を有するが、独立気泡構造を有することが好ましい。その理由は、独立気泡構造は、加熱成形時の芯層の圧縮反力が高く、低密度でも圧縮強度が高いからである。芯層の独立気泡率は50%以上が好ましく、更には70%以上であることが好ましい。これにより、加熱成形時の芯層の圧縮反力が更に高くなり、また低密度でも圧縮強度が高い樹脂複合成形体を得ることができる。

【0033】本発明に用いる発泡樹脂粒子は、成形型内に入れ、比較的低温・低圧のスチームや乾燥ガスからなる熱風を用いて融着させれば、加熱成形時に、高温・高圧スチームを用いた場合に比べて発泡樹脂粒子の空隙又は粒子の中には、水蒸気の浸入が少ない。それゆえ、水蒸気の凝縮による体積収縮に伴う成形体の体積収縮も少なく、その結果この樹脂複合成形体は形状安定性に優れている。また、寸法及び収縮変形を矯正するための高温養生処理も不要若しくは短時間で済む。

【0034】また、比較的低温・低圧の水蒸気や乾燥ガスによる加熱成形では、従来の発泡樹脂粒子の加熱成形時に用いられていた高圧蒸気圧に耐える構造の重量ある金型が不要であり、熱エネルギーの消費量も少ない。また、熱可塑性樹脂からなる表皮と発泡樹脂粒子とを型内で一体成形を行う場合には、水蒸気の水分の影響による融着不良が少なくなるため、熱可塑性樹脂からなる表皮層と発泡樹脂粒子の被覆層とが強固に融着する。従って、本発明の樹脂複合成形体は融着強度が高く、機械的強度に優れている。

【0035】このような発泡樹脂粒子からなる発泡体層と積層状態で融着一体化される表皮層及び基材は発泡樹脂粒子を成形する金型に予め配置しておくか、発泡樹脂粒子を所定形状に成形後融着する等して積層すればよい。表皮層としては、発泡樹脂粒子(発泡樹脂粒子の被覆層)との熱融着性を保持しつつ表面特性を維持するため粒子の被覆層を構成するボリエチレン系樹脂の融点(実質的に融点を示さない場合は前記と同様に考える)

より5℃以上融点の高い熱可塑性合成樹脂が用いられ る。

【0036】表皮層を構成する樹脂の具体例としては、 ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリオレ フィン系エラストマー等のポリオレフィン系樹脂が好適 に用いられる。これらポリオレフィン系樹脂は、単独使 用の他2種以上の組成物であっても良い。表皮層として は、発泡樹脂粒子の被覆層の融点より5℃以上、好まし くは10℃以上融点の高い熱可塑性樹脂から構成されて いることが肝要である。また、表皮層は単層のみなら ず、多層のものも用いられ、フィルム状、シート状、予 めある程度成形された真空成形品、圧縮成形品、スラッ シュ成形品、インジェクション成形品などが用いられ、 その厚みは、 $0.3 \sim 5 \, \text{mm}$ 程度のものが使用される。

【0037】本発明の複合体を製造する一例として金型 成形が挙げられる。具体的には、加熱空気や蒸気によっ て加熱可能とされた金型に表皮層を配置し、要すれば他 方側に、比較的硬質の合成樹脂板等からなる基材を配置 し、表皮層の裏側(表皮層と基材との間)に発泡樹脂粒 子を充填し、加熱空気や蒸気によって加熱し、発泡樹脂 20 いる。 粒子同士および発泡樹脂粒子と表皮層(および基材)と の融着を行い一体化する方式が一般的に用いられている が、この際、発泡樹脂粒子同士が融着する温度で加熱し ても表皮層のシボ模様等の凹凸模様が消えたり、不鮮明 になったり、表皮層の光沢が悪くなったりしないための 条件が、上記した融点差である。

【0038】成型法としては上記に止まらず、図2、図 3に示したような、表皮層を真空成形し、表皮層が固化 する前に予め成形しておいた発泡体層を押し込んで融着 一体化する方法、または発泡体層の上に表皮層を圧着す 30 る方法等が考えられる。この場合、真空成形型にシボ模 様を形成しておけば表皮層に模様づけも行える。

【0039】表皮層の反対側に設けられる基材としては 通常は比較的硬質のポリオレフィン系樹脂が用いられ る。この基材は一般には形状保持、車体等の他の物への 固定保持部として用いられ、表面には露出しないので表 面模様等に気を付ける必要はない。基材の材質としては 発泡体との接着性を考慮し、ポリオレフィン系樹脂を用 いるのが良い。発泡体、表皮層、基材を全てポリオレフ ィン系樹脂で構成すれば、回収品等を粉砕、リサイクル 40 する際に再生がし易く好ましい。

【0040】一般的な成形方法は、表皮層と基材を各々 配置した型内に、発泡樹脂粒子を充填した後、型内に充 填された発泡樹脂粒子間の間隙に加熱蒸気や熱風を通過 させて加熱し、発泡樹脂粒子を融着させた後、冷却して 複合成形体を形成するが、図2及び図3に示されるよう にして複合成形体を形成することもできる。

【0041】すなわち、図2に示されるように表皮層1 0の上下面側にヒータ11aを内蔵した2つの熱板11 を移動させて位置決めし、これを挟んで両面を加熱し、

表皮層10の表面を所定温度に加熱した後に熱板11を 元の位置に移動させ、表皮層10を真空成形型12に配 置し、次いで真空成形型12にあけた多数の穴13から 真空引きをして表皮層10を真空成形型12に密着させ

【0042】その後、図3に示すように、真空成形型1 2に密着配置された表皮層 10の所定位置に、既に説明 したようにして予め成形された発泡樹脂粒子からなる発 泡体層14の一方の面を、表皮10の表面が軟化高温状 態にある内に押し付ける。この発泡体層14の他方の面 には予め基材が配置されている。次いで、もう1つの型 を被せて複合成形体を形成する。このように、予め成形 された発泡体層14を、表皮層が配置された型内に入れ て最終成形品を形成することもできる。

【0043】図4は、本発明のポリオレフィン系樹脂複 合成形体を自動車のダッシュボードの成形に適用した場 合における当該成形体の一部を破断して示す断面図であ る。このダッシュボード15は、図4に示されるように 表皮層10と発泡体層14と基材16とから構成されて

【0044】表皮層10は、ポリプロピレン系樹脂から なるシートで形成され、表面には梨地模様が施されてい る。この表皮層10はポリエチレン系、ポリブロピレン 系、スチレンープチレンースチレンブロック共重合体 (SEBS) 等で形成することもできる。また、基材1 6はポリプロピレン製でフィラーの入ったソリッド樹脂 からなり、この基材16と表皮層10とに充填されてい る発泡体層14は、前述した熱可塑性発泡樹脂粒子を用 いて形成されている。

【0045】このように本発明のポリオレフィン系樹脂 複合成形体を、例えば自動車などのダッシュボードとし て形成した場合、表皮層10の表面に梨地模様などを形 成した場合でも、発泡体層を構成する発泡樹脂粒子の被 覆層の融点が、表皮層のそれより5℃以上低く、その結 果発泡樹脂粒子同士が融着する温度に加熱しても表皮層 の模様が樹脂複合成形体の製造時に損なわれるようなこ とがない。

【0046】また、発泡体層の圧縮硬さを、0.05~ 0. 7MPaとすることにより、表皮層の表面外観がよ く且つクッション性に優れ、しかも樹脂複合成形体とし ての所定強度も得ることができることから、車両のダッ シュボード等への適用に特に好ましい。

#### [0047]

【実施例】次に、本発明におけるポリオレフィン系樹脂 複合成形体を実施例より更に詳細に説明するが、本発明 は、その要旨を越えない限り、以下の実施例に限定され るものではない。

(実施例1)内径40mmの単軸押出し機を使用してエ チレン含量1.5重量%のエチレン・プロピレンランダ 50 ム共重合体(融点153℃)を混練し、内径26mmの

10

9

単軸押出し機を使用して密度0.907のメタロセン触 媒で重合された直鎖状低密度ポリエチレン(融点100 ℃)を混練した。次いで、直径1.5mmのダイオリフ ィースを有するダイから、エチレン・プロピレンランダ ム共重合体を芯層とし、直鎖状低密度ポリエチレンを被 覆層としてストランドを押し出した。

【0048】さらに、このストランドを、水槽を通して 冷却した後、1.2mgに切断した。この複合体粒子の 断面を位相差顕微鏡により観察したところ、厚さ30μ ランダム共重合体を被覆していた。

【0049】次に、密閉容器内に上記の複合体粒子10 0 重量部、水2 5 0 重量部、粒径 0. 3~0. 5 μmの 第三リン酸カルシウム1.0重量部及びドデシルベンゼ ンスルホン酸ナトリウム0、007重量部を仕込み、次 いで、攪拌下にてブタン20重量部を密閉容器内へ供給 した。内容物を充填率62%で充填した後、一時間かけ て145℃まで昇温して同温度で30分間保持した。

【0050】その後、密閉容器の底部にある放出孔の弁 を開くと共に外部より密閉容器内の気相部へ窒素ガスを  $20 \sim 5$ 、比較例  $1 \sim 2$  においては、表 1 に示すごとく、芯 導入し、容器内の圧力を保持しつつ内容物を大気圧下へ 放出して発泡樹脂粒子を得た。こうして得られた発泡樹 脂粒子は、平均嵩密度17Kg/m³、平均気泡径23 0μmであり、発泡樹脂粒子同士のブロッキングもなか った。

【0051】この発泡樹脂粒子の断面を位相差顕微鏡に て観察したところ、芯層のエチレン・プロピレンランダ

ム共重合体は、独立気泡の発泡状態にあり、一方、直鎖 状低密度ポリエチレンは、実質的に非発泡のフィルム状 態で、エチレン・プロピレンランダム共重合体の発泡状 態の芯層を被覆していた。発泡樹脂粒子の長径Lと短径 DとのL/Dは、0.9である。

【0052】この発泡樹脂粒子を40℃の乾燥室にて完 全に乾燥し、表皮層(材質:ポリプロピレン系樹脂シー ト、厚さ:0.8mm、融点:153℃)と基材(材 質:ポリプロピレン系樹脂、厚さ:4mm、融点164 mの直鎖状低密度ボリエチレンがエチレン・プロピレン 10 °C)を各々配置した通気性のある型内に、この発泡樹脂 粒子を充填した後、型内に充填された発泡樹脂粒子間の 間隙に熱風を通過させて、発泡樹脂粒子の表面温度を1 20℃に加熱し、次いで、型内容積を60%に減容した 状態で、発泡樹脂粒子を融着させた。その後、空気にて 冷却し、型内より複合成形体を取り出した。発泡体層の 密度は28Kg/m³であり、成形体の大きさは縦20 0mm、幅300mm、厚み40mmであり、含水もな く、収縮変形のない型通りの形状であった。

> 【0053】(実施例2~5、比較例1~2)実施例2 層の樹脂及び状態、被覆層の樹脂及び状態、平均嵩密 度、L/D比、表皮層の樹脂及び状態、加熱成形温度、 圧縮率を変えて、発泡成形体を製造した。その他は、実 施例1と同様に製造した。

[0054]

【表1】

-	実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5	比較例1	比較例 2
志履の樹脂 耐点 (℃)	ET-PR 159	ET-PR 153	ET PR 141	ET-PR 141	ET-PR 153	ET-PR 153	ET-PR 153
被機層の樹脂 融点 (℃)	N-LLDPE 100	N-LLDPE 100	LLDPE 123	LLDPE 123	N-LLDPE 100	ET-PR 142	_
平均嵩密度(Kg/m³)	17	18	17	18	17	18	18
L D比	0. 9	2. 0	1. 2	1.5	0. 9	1. 3	1.1
芯層の状態	発泡	竞抱	発泡	発泡	免抱	発泡	発泡
被覆層の状態	爽質非発泡	実質非発泡	実質非発泡	突質非発泡	臭質非発泡	発泡	_
表皮層の樹脂 離点 (℃)	ET-P¥ 153	ET-PR 153	EDPE 131	HDPE 135	HDPE 131	ET-PR 153	HDPE 135
加熱成形温度(℃)	130	125	125	128	115	130	125
圧着率(%)	40	10	30	3	40	30	30
発泡体層 美密度(Kg/n³) 空隙率	28	20	24	18. 5	28	融着せず	融着せず
	1<	80	10	85	1<	侧定不可	樹定不可
融着試験	0	0	0	0	0	Y	Y

BT-PR:エチレン-プロピレンランダム共重合体

M LLDPE:メタロセン触媒で重合された直鎖状低密度ポリエチレン

ししDPB:直鎖状低密度ポリエチレン

HDPE:高密度ポリエチレン

○:発泡体層が表皮層と一体化、接着し、収縮変形等外観不良のないもの。 ×:発泡体層が表皮層と分離したり、表皮に変形、収縮等が観られるもの。 11

(融点) 示差走査熱量計(DSC)により測定した。先 ず、3~5mgの樹脂をその結晶が融解する温度まで昇 温後、10℃/分の速度で室温まで冷却した。次いで、 10℃/分の速度で加熱昇温し、得られる吸熱曲線のピ ーク温度をもって融点とした。

【0056】〈発泡体層の嵩密度〉最終成形品より発泡 体層を切り出し、単位体積当たりの重量 (Kg/m³) を測定した。〈発泡体層の圧縮率〉

12

【式1】

# (発泡体層の嵩密度 – 発泡樹脂粒子の嵩密度) ×100(%)……式(1)

#### 発泡体層の常密度

〈空隙率〉内径150mm、容積5リットルの目盛り付 100×30mm (体積0.3リットル) の発泡体層試 験片を水没させて、このときの水面の示す容積V(リッ トル)を測定し、式(2)により空隙率を求めた。 【式2】

{1-(V-3) /0.3} ×100% ········式(2)

【0057】〈表皮の融着状況〉型内より取り出した複 合成形体を温度20℃に放置し、30分後の外観を目視 にて判定した。

【0058】なお、前述した本発明の実施例5は、自動 20 車などのダッシュボードを例に挙げて説明したが、本発 明はこのような用途に限定されるものではなく、緩衝性 能、断熱性能、又は遮音性能を必要とする内装材、例え ば断熱パネル、或いは椅子や机などの家具類等に適用す ることができることは勿論である。

[0059]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のポリオレ フィン系樹脂複合成形体によれば、表皮層の表面品質を 劣化させることがない程度の温度で発泡体層の成形がで き、発泡体層と表皮層又は/及び基材との接着性に優れ 30 た樹脂複合成形体を得ることができる。

【0060】また、本発明のポリオレフィン系樹脂複合 成形体によれば、熱可塑性樹脂発泡粒子における被覆層 の融点が、表皮層の融点より低く設定されているため、 表皮層の外観が損なわれず、また発泡体層に空隙を持た

せているため、吸音効果もあり、更に発泡樹脂粒子の平 メスシリンダー内に水3リットルを入れ、寸法100× 10 均粒子径が小さいため複合成形体の厚みをより薄くする ことができる等優れた効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のポリオレフィン系樹脂複合成形体を構 成する発泡体層の熱可塑性発泡樹脂粒子を示す斜視図で ある。

【図2】本発明のポリオレフィン系樹脂複合成形体の形 成する際の工程途中を示す概略的な断面図である。

【図3】図2に示される樹脂複合成形体の形成工程に引 き続く工程を概略的に示す断面図である。

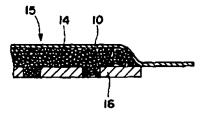
【図4】本発明のポリオレフィン系樹脂複合成形体を自 動車のダッシュボードに適用した一実施形態の部分的な 断面図である。

#### 【符号の説明】

- 1 熱可塑性発泡樹脂粒子
- 2 芯層
- 3 被覆層
- 10 表皮層
- 11 熱板
- 11a ヒータ
- 12 真空成形型
- 13 真空引き通路(穴)
- 14 発泡体
- 15 ポリオレフィン系樹脂複合成形体からなるダッシ ュボードの一部
- 16 基材

【図1】 【図2】 【図3】

【図4】



# フロントページの続き

Fターム(参考) 4F100 AK01B AK01C AK03C AK04B

AK07 AK63 AK64 AS00C AT00A BA02 BA03 BA07 DD31B DJ01B DJ05B GB33 JA04C JA11B JA20B JB16B JB16C JK05B JL11 YY00B